

恒坤HENGKUN

厦门恒坤新材料科技股份有限公司成立于1996年，于2015年在新三板挂牌，公司专注于集成电路先端材料的研发、生产和销售，经过多年事业布局，公司已成为国内外出色的芯片企业供应商。

公司产品广泛应用于移动互联终端、智能可穿戴设备、车载工控系统等产业。目前恒坤主要布局半导体、新能源汽车等领域的先端材料技术引进、市场应用和本土化生产，已经从手机产业转型到半导体材料。

恒坤足迹遍布全国，分别在苏州、深圳、香港、上海、大连、武汉、日本及韩国设有工厂、分公司和办事处。

目前，恒坤集团旗下半导体公司规划有研发中心、半导体前驱体工厂、光刻胶工厂以及研磨液工厂。恒坤半导体团队主要来自英特尔，台积电，中芯国际，平均工作经验15年，团队国际化掌握多门语言。其中，前驱体工厂主要生产TEOS及其他前驱体，光刻胶工厂规划生产光刻胶及感光材料，研磨液工厂规划生产研磨液及其他大宗化学品。恒坤拥有自主的光刻胶技术，并与韩国知名半导体材料企业合作，引进前驱体技术在国内实现本土化生产。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/hkhengku-668608.html>